

2025年 法人說明會

發言人 盧修滿 2025.06.26

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



公司簡介

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

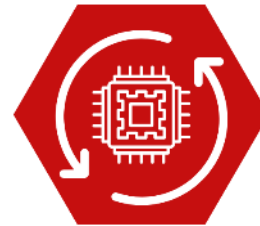


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿



營運報告

(2025 Q1)

綜合損益表

創近12年同期單季新高

2025年
Q1

(NT\$仟元)	2021	2022	2023	2024	Q1 2025	QoQ	YoY
營業收入	1,218,919	1,060,398	976,397	1,153,486	301,151	-3%	26%
營業毛利	310,457	310,949	255,756	284,926	72,596	5%	15%
毛利率	26%	29%	26%	25%	24%	8%	-9%
營業淨利	150,568	124,057	75,279	78,293	22,457	51%	70%
營業外收(支)	15,294	110,067	36,565	65,185	19,679	-29%	-17%
稅前淨利	165,862	234,124	111,844	143,478	42,136	-1%	14%
本期淨利	134,428	195,976	93,545	107,452	35,650	-1%	15%
淨利率	11%	18%	10%	9%	12%		
EPS (NT\$) 註:	3.36	4.90	2.12	2.39	0.79	-2%	15%

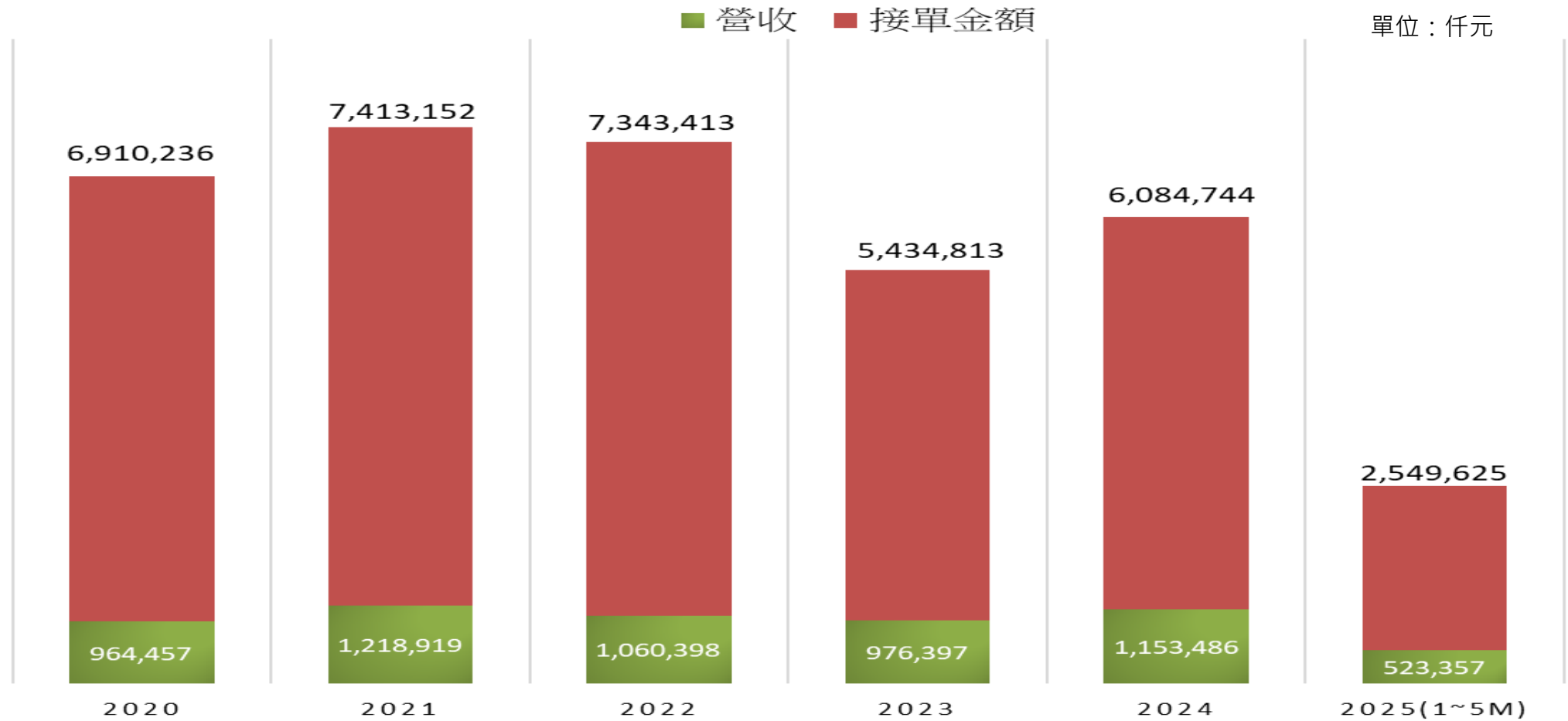
資產負債表

NT\$仟元	2022	2023	2024	Q1 2025
資產				
現金及約當現金	327,431	398,797	333,159	244,289
應收帳款	532,247	443,432	550,367	597,751
存貨	60,048	67,008	60,611	54,235
轉投資相關	257,247	263,434	252,910	264,746
不動產、廠房及設備	226,154	223,341	286,419	288,953
其他資產	26,539	34,288	29,040	44,017
資產總計	1,429,666	1,430,300	1,512,506	1,493,991
負債				
短期借款	150,000	-	-	-
應付帳款	227,968	233,559	315,611	254,850
其他負債	131,435	110,272	122,610	217,684
負債總計	509,403	343,831	438,221	472,534
權益總計	920,263	1,086,469	1,074,285	1,021,457
淨值 (NT\$元 /股)	23.53	24.63	23.87	22.70

歷年營收/接單金額

2013-2024 CAGR(複合成長率)

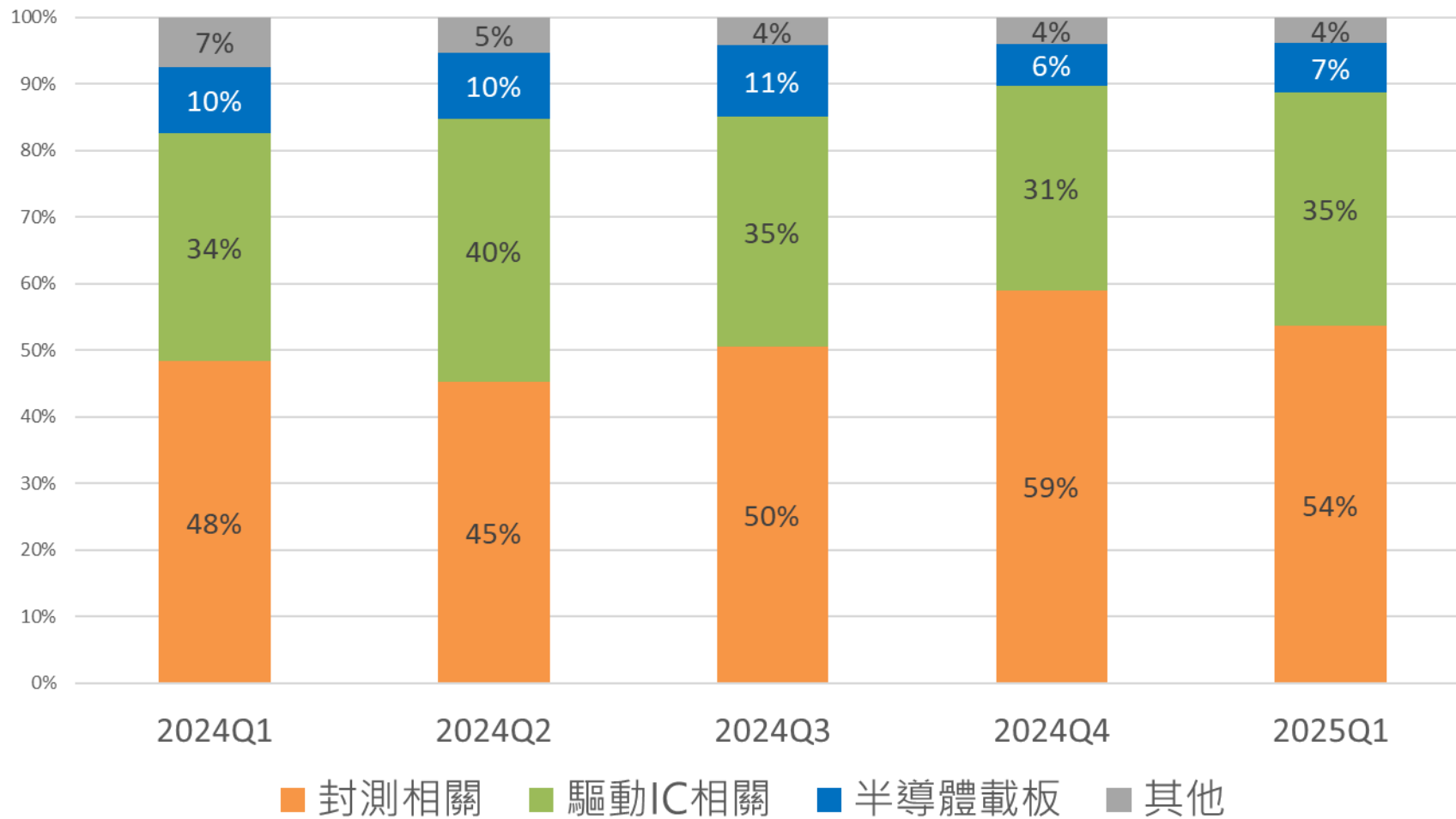
營收：3.3% 接單金額：8.4%



說明：營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

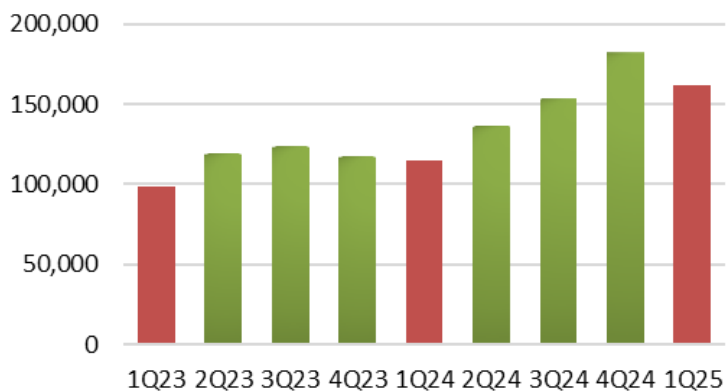
產品別營收佔比



主力產品別季度營收

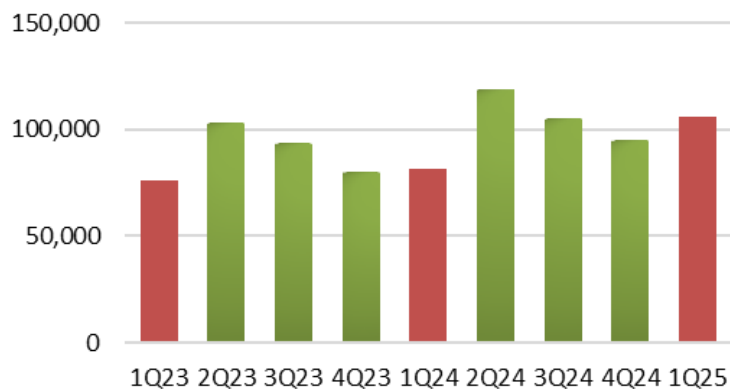
封測相關

YoY 40%、QoQ -12%



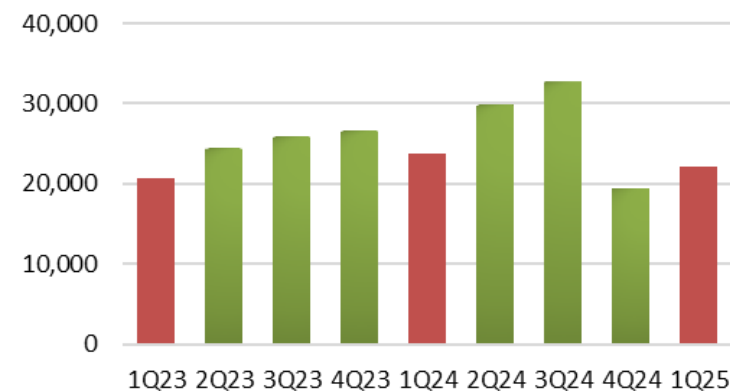
驅動IC

YoY 30%、QoQ 11%



半導體載板

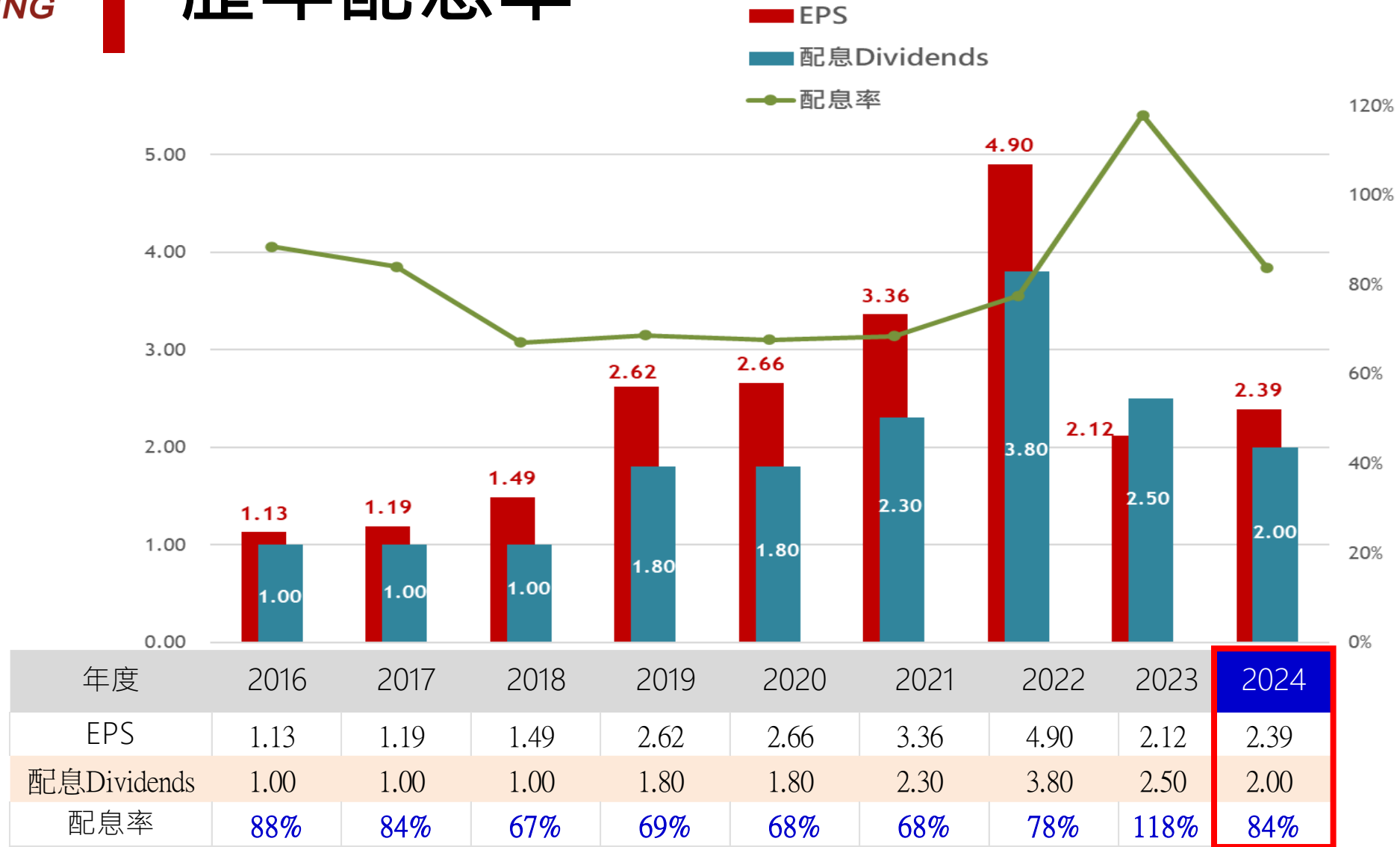
YoY -7%、QoQ 14%



2025年 第一季營運成果

- 一. Q1合併營收3.01億元，較去年同期2.38億元大幅成長26%，創下近12年同期單季新高。
- 二. 單季營業毛利7,260萬元，年增15%、季增5%，毛利率達24%。每股稅後純益達0.79元，較去年同期的0.69元年增15%。
- 三. 今年首季受惠先進封裝需求持續增溫，帶動封測材料出貨穩健，雖為傳統淡季，營運仍呈現淡季不淡格局，為全年成長奠定良好基礎。

歷年配息率



註：係為追溯調整後



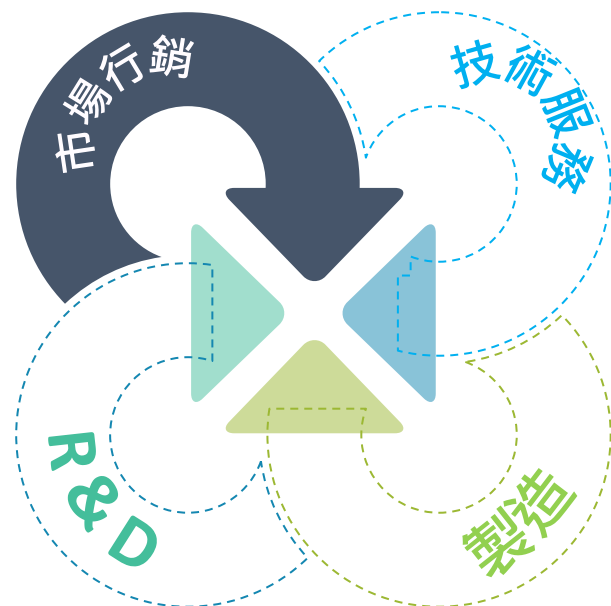
營運展望

策略一：整合材料解決方案

載板成長策略

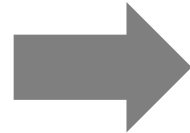
垂直整合服務

as is



Team STN

■ 銷售能力 ■ 技術能力



- 強化與Simmtech關係
- 擴大邏輯IC 載板市場

To be



策略一：整合材料解決方案

均熱片成長策略

垂直整合技術



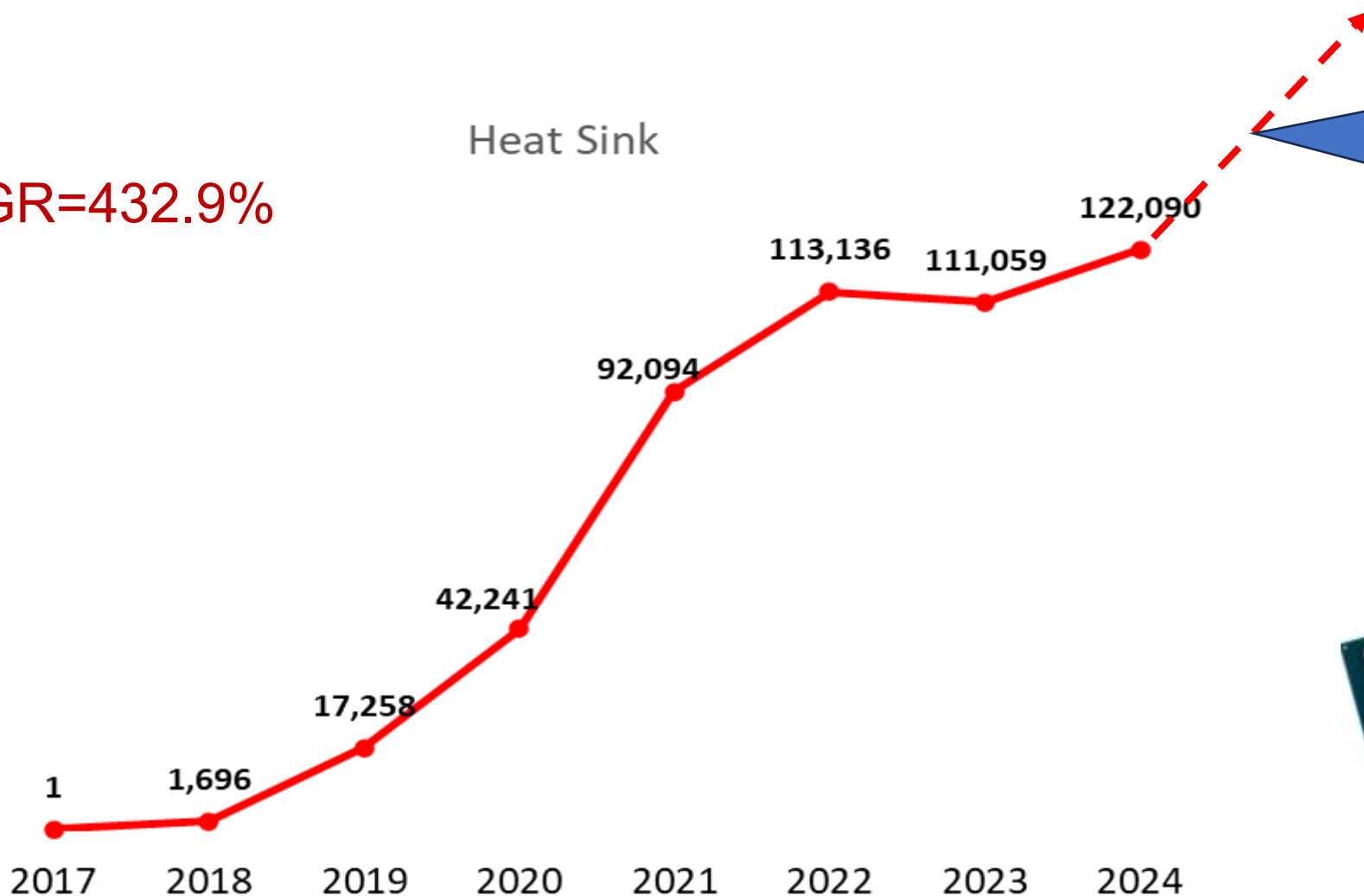
均熱片歷年營收

2025 YoY>50%

CAGR=432.9%

Heat Sink

單位：仟元



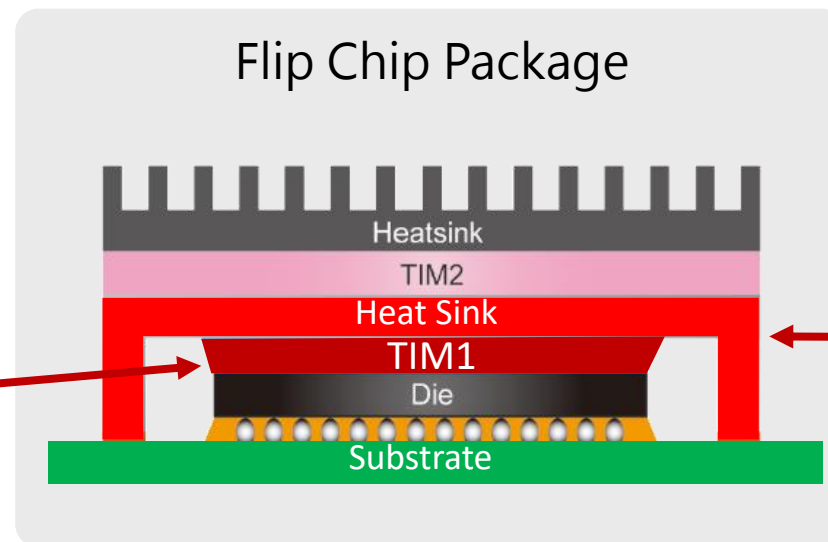
2025 1-5月累計
YoY 165%
已達去年全年65%



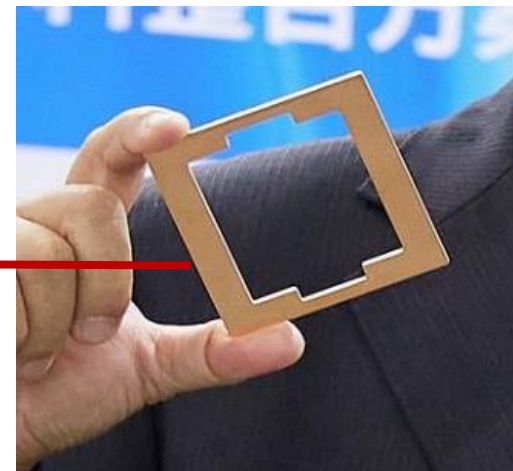
IC散熱解決方案

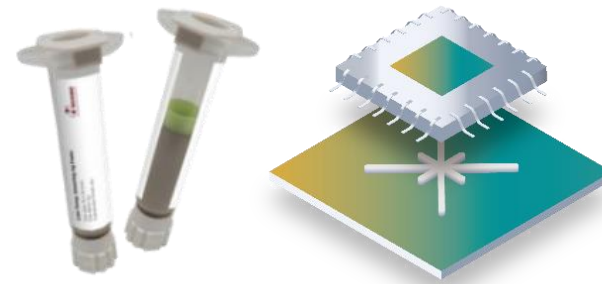
因應AI新應用、高階封裝需求帶動散熱相關市場的成長

銀漿



均熱片





自有銀漿研發

客製化銀漿

IOT



1. 快速固化
2. 高導電性
3. 低功率損耗

車用電子



1. 高附著強度
2. 高信賴性

燒結銀膠

IGBT / GaN / SiC



1. 適用大尺寸
($> 8 \times 8$ MM) 晶片
2. 超高散熱性
(> 200 W/MK)

高功率LED



1. 超高散熱性
($150 \sim 200$ W/MK)
2. 高信賴性
3. 175°C 燒結銀

高導熱銀膠

MOSFET



1. 高導熱性
2. 高韌性
3. 高信賴性

策略二：發展自有先進材料

燒結銀成長策略

聚焦、突破、成長三部曲

1. 選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場
2. 聚焦優勢技術(固化技術)，發現下一個價值型產品



選擇重點客戶

建立全球市場知
名度

聚焦70%客戶
使用市場

加速成長

- 短期: 客戶應用以光學類為主。
- 中期: 針對國際重點客戶提供客製化服務。
- 長期: 跨入車用及超高功率元件。

產品別發展概況

- AI與先進封裝需求續強，持續挹注營收與毛利。
- 客戶提前備貨效應仍在，出貨動能維持高檔。
- 終端市場尚未明顯復甦，短期以去庫存為主。
- Q3隨手機發表、假期備貨需求增溫，需求有望上揚。
- 因AI需求、客戶拉貨，訂單爆單。
- LPDDR5X (AI server)、GDDR7 (GPU) 預計下半年導入市場。
- Q1、Q2 中國客戶進入小量產。
- 跨入台灣Tier1 車用模組散熱材料。
- 持續拓展高潛力代理項目，聚焦先進封裝應用技術，已有多項新產品線完成洽談並展開推廣。



- 一. **2025年Q1:** 受惠先進封裝需求持續增溫，帶動封測材料出貨穩健，營收創12年同期單季新高。
- 二. **後續展望:** Q2整體營運動能延續Q1成長態勢。Q3驅動IC需求上揚、IC載板逐步回溫，整體動能穩中透強。2025年整體營運展望樂觀，全年業績表現預期將較去年同期呈現顯著成長。
- 三. 全球貿易局勢雖持續變動，利機亦持續主動應變，重點作法如下：
 - 1. 緊密掌握客戶動態與市場變化，快速調整供應與配銷節奏。
 - 2. 積極拓展高附加價值產品代理線，提升整體毛利結構。
 - 3. 優化產品組合結構，穩健提升整體獲利品質與營運效率。
 - 4. 聚焦先進封裝應用技術，持續導入具潛力之新興代理產品線。

THANK YOU

